

2023年10月20日

一般社団法人 電子情報技術産業協会  
事業推進部

## JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会 2023

新型コロナウイルス感染症の流行により、ニューノーマル時代に様々な対応が求められる今、今後の経済や企業の取り組みも大きく変わろうとしています。

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に、1997年からはんだ鉛フリー化をはじめ、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組み、活動成果は毎年「活動報告会」を開催して広く普及を図って参りました。変革期を迎える今年も、先端的な実装技術の検討結果をご紹介させて頂くべく『JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会 2023』（Webによるリモート報告会）を開催することとしました。

今回は、2件の基調講演にて先端研究のご紹介を頂くとともに、経済産業省プロジェクトの進捗報告、JEITA規格等の標準化動向など、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜り、各社の事業にお役立て頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

日 時：2023年11月20日(月) 13:00～16:50

■ 申込サイト：<https://www.jeita.or.jp/form/custom/299/form>

■ 主 催：実装技術標準化専門委員会

■ 開催形態：オンライン会議システム（WebEX）による報告会

■ 参加費：無料（PDF資料を含む）

■ 申込方法：上記申込サイトからお申し込み下さい。

資料及びオンライン会議（WebEX）参加案内は、開催3日前を目途にご連絡致します。

■ 申込期限：2023年11月14日(火)

■ 事務局：一般社団法人 電子情報技術産業協会 事業推進部（布川・澤田）

E-mail：tsc4@jeita.or.jp

## ■プログラム

〔司会：中林 種広 JEITA 実装技術標準化専門委員会副委員長 (株)村田製作所〕

### 〔挨拶及び全体説明〕

#### 【主催者挨拶】

13:00-13:05 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長  
東芝デバイス&ストレージ(株)

#### 【来賓挨拶】

13:05-13:10 石川 雄太郎 氏 経済産業省商務情報政策局 情報産業課 課長補佐

#### 【基調講演 1】

13:10-13:50 「先端ロジック技術の動向」  
平本 俊郎 氏 東京大学 生産技術研究所 教授

### 〔METI プロジェクト〕

13:50-14:30 「複合材料電子回路基板の放熱設計手法に関する国際標準化プロジェクト」  
畠山 友行 複合材料電子回路基板の放熱設計手法に関する国際標準化研究  
委員会副委員長 富山県立大学  
福江 高志 温度測定 WG 主査 金沢工業大学  
真田 和昭 熱伝導率測定方法 WG 主査 富山県立大学  
14:30-14:50 「三次元電子モジュールに関する国際標準化」  
加藤 義尚 部品内蔵技術標準化研究委員会委員長 福岡大学  
14:50-15:10 「電力半導体デバイス接合部の国際標準化の現状について」  
二宮 良次 電力デバイス接合材料の国際標準化フォローアップ PG 副主査  
東芝デバイス&ストレージ(株)

----- (休憩 10 分) -----

### 〔JEITA 規格・技術〕

15:20-15:50 「実装用 MID テクニカルレポート PG の活動紹介」  
坂本 一三 JEITA 実装用 MID テクニカルレポート PG 主査 S.C.L  
15:50-16:10 「はんだ付け試験標準化 G」  
諏訪 正樹 はんだ付け試験標準化 G 主査 KOA(株)

#### 【基調講演 2】

16:10-16:50 「先端パッケージ技術の動向」  
菅沼 克昭 氏 大阪大学産業科学研究所  
フレキシブル 3D 実装協働研究所 所長／特任教授

※ プログラムは変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。